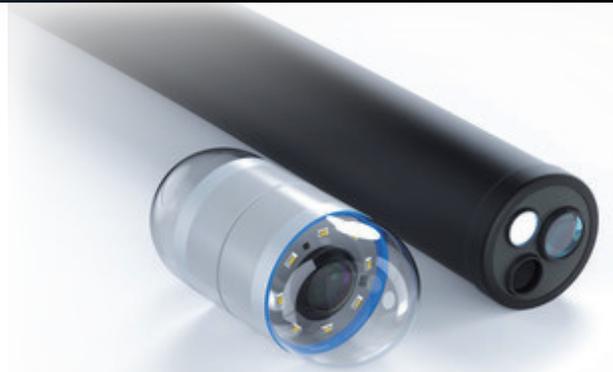


# 4層穴埋めブラインドビアFPC

小型化が必要とされている  
高解像度画像診断装置、  
内視鏡、カテーテルに！

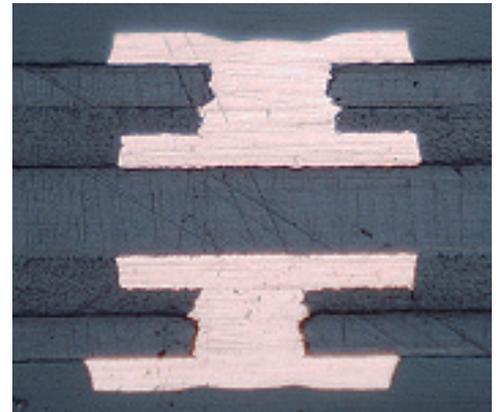
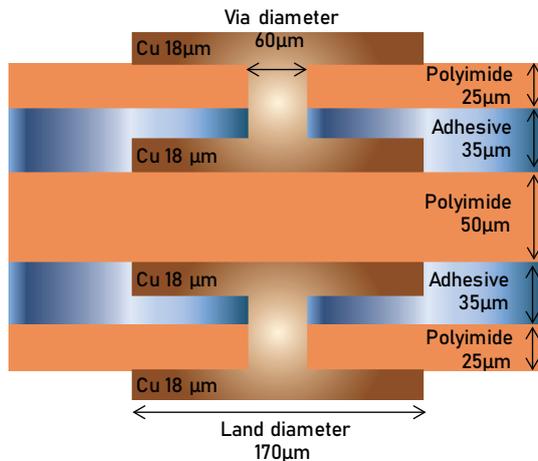


## 製品特徴

- 4層FPCでめっきによるブラインドビアの穴埋めが可能です。
- ビアの上に部品実装が出来るので省スペース化が可能です。
- リジッド基板と比較し軽量化できます。

## 仕様

ベースポリイミド : 50um  
導体厚み : 18um  
穴径 (上側) : 60um  
穴径 (下側) : 60um  
ランド径 : 170um



## 信頼性試験

### 冷熱サイクル評価

評価方法 : JIS C5016 9.1 -65℃ ~ +125℃ 100 サイクル

合格基準: 導通抵抗±10%以下

ALL PASS

